

2021년 열린 혁신 디지털 오픈랩 구축 ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 제작전문기업 모집 공고문 (바우처 공급)

ICT 디바이스 제품화를 위한 시제품 제작이 필요한 수혜기업을 대상으로, 디자인, PCB 설계, 외형, SW, 인증 분야 전문기업을 모집하고자 합니다. 제작전문기업 선정 시 바우처 지원을 통하여 이를 수행 하고자 하오니 제작전문기업의 많은 신청 바랍니다.

2021년 6월 11일

디지털 오픈랩

1 사업개요

가. 사 업 명 : [열린 혁신 디지털 오픈랩 구축 ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 사업

나. 사업목적

- 1) 국내 제작기반(바우처 제작전문기업)을 활용, ICT 디바이스 시제품 제작을 지원하여 제품 제작 생태계 제고 및 중소·스타트업의 사업화 역량 강화를 통한 관련 산업의 활성화 지원
* 제품화 바우처 : 사업관리 기관이 수혜대상에게 제작 전문기업을 선택하여 제품화할 수 있도록 현금이 아닌 제품개발에 필요한 서비스(디자인·PCB설계·외형·SW·인증) 이용 권(바우처)을 부여, 그 비용은 사업관리 기관이 제작전문기업에게 지급
- 2) 디자인제작, PCB 설계제작, 외형제작, SW, 인증 분야 제작전문기업의 참여유도를 통해 제품화 지원의 전문성 강화와 안정적이고 고품질의 제작 서비스를 공급하여 수혜자 중심의 디바이스 제품화 지원체계 구현

다. 사업기간 : 2021. 7 ~ 2021. 11

라. 사업내용

- 1) ICT 혁신 디바이스 제품화를 위한 제작전문서비스 제공이 가능한 중소·중견기업을 대상으로 바우처 제작전문기업에 선정된 제작전문기업을 분야별 매칭하여, 제작전문기업과 협의하여

100~500만원 금액 내에서 지원을 받으며, 필요시 수혜기업에서 추가 금액을 지불하여 지원 프로그램을 활용할 수 있도록 전문 제작 서비스 제공

* 지원기업 바우처 건당 최대 5백만원 이내

2) 수도권(판교)의 디지털 오픈랩을 활용한 디자인제작, PCB 설계제작, 외형제작, SW, 인증 분야 지원을 위한 바우처 제작전문기업 Pool 구성

- 바우처 적용 프로그램은 제작 분야별, 지역별 수혜 등을 반영하여 개별 선정
- 지원내용은 수혜기업의 개발내용에 따라 지원 및 범위(안)을 참고하여 결정
- 수혜기업의 선택이 없을 경우 사업진행이 불가할 수 있음

3) 디바이스 제품화 바우처 분야(디자인 제작^①, PCB 설계제작^②, 외형 제작^③, SW^④ 인증지원^⑤)

① (디자인제작) 디자인 기획(컨셉 시각화, 스케치), 모델링(3D 모델링 & 렌더링), 디자인 시방서 등 23차원 제품 디자인 개발 등 지원

< 지원 내용 및 범위(안) >

구 분		지원내용
디자인 제작	디자인 리서치	- 디자인 트렌드 조사, Needs 조사, IP 조사
	디자인 방향성 (Sketch, Ideation)	- 아이디어 Sketch를 통해 Design Concept 정리(3 Type) - 기능성 등을 고려한 기존 디자인 설계 검토
	3D Modeling & Rendering	- 3차원 형상으로 제품디자인을 다양한 관점(view)에서 검토, 실제와 유사한 재질감 부여를 위해 Rhino 3D, Key Shot를 이용하여 표현(3 Type)
	최종 결정 디자인 3D 시뮬레이션 동영상	- 최종 결정된 디자인에 대한 이해를 돕기 위해 3D 시뮬레이션 동영상 제작(AVI, 30초 이내)
	디자인 수정	- 기구설계 진행 이후 디자인 부분 수정 및 디테일 수정에 대한 Feedback 작업(1회)
	디자인 시방서 지원	- 제품의 샘플제작(Design & Working Mocup)을 위한 Color 및 인쇄, 재질 시방서 지원 - Design Soft Mocup sample 1ea(제품 수준에 따라 최종 디자인 샘플 1ea, 3D 프린팅_FDM 적용)
	디자인출원등록	- 최종 결정된 디자인 안에 대한 지적재산권을 보호하고 향후 디자인 분쟁에 대한 대비책의 일환으로 디자인출원 등록 지원(1회)

※ 상기 내용은 분야별 지원 가능한 세부 내용을 제시한 것으로 수혜기업은 제작전문기업과 협의(견적서 등)를 통해 지원 내용을 결정하고 예산 한도 내(100~500만원)에서 지원하고 필요시 수혜기업에서 추가 금액을 지불하여 제작가능

② (PCB 설계제작) 회로 설계 및 제품회로 구조 최적화를 통한 PCB 제작 및 조립 등 지원

< 지원 내용 및 범위(안) >

구 분		지원내용
PCB 설계 제작	회로 설계	- 회로보완 설계, 부품 spec 및 제품 기능 개선 사양 제안 - 외형을 고려한 회로 구조 최적화 검토 지원
	PCB 외형 설계	- 부품별, 부분 및 전체 조립부별 PCB 외형 설계 사전검토
	PCB 설계	- 층수, 두께, 재질, 표면처리방법 등 선정 지원 - PCB 제작용 거버데이터 도출 - 임피던스, 빌드업 설계 및 부품특성을 고려한 설계지원
	PCB 제작·조립	- 기능 및 성능 검토 후 PCB 제작 - PCB기판에 부품 납땜 조립(SMT) - 부품 구매 조달 - SOLDERING 방안 제안:무연,유연등 - 기능 검증

※ 상기 내용은 분야별 지원 가능한 세부 내용을 제시한 것으로 수혜기업은 제작전문기업과 협의(견적서 등)를 통해 지원 내용을 결정하고 예산 한도 內(100~500만원)에서 지원하고 필요시 수혜기업에서 추가 금액을 지불하여 제작가능

- ③ (외형제작) 산업용 3D 프린터, CNC 가공 등을 통한 외관제작, 스트 샘플 및 목업제작 (Prototyping/Styling/Working Mockup) 등 지원

< 지원 내용 및 범위(안) >

구 분		지원내용
외형 제작	모델링 검증	- 3D data의 형상구현이 제작을 감안한 완벽성 검증 (Data찢어짐, 변형)
	공차검증	- 외형 형태를 구현하기 위한 정적해석, 열해석 - 기구물 조립과 이에 따른 성능 구현을 위한 공차 설정 검증
	기구설계	- 제품의 형태나 부품의 두께, 무게 등 내부 부품 구조를 고려한 설계
	재질 선정	- 제품에 적합한 재질 등 선정
	가공	- CNC·ABS 가공, 도색·도장(후가공)
	목업제작	- 테스트 샘플 및 목업 제작(Prototyping/Styling/Working Mockup)

※ 상기 내용은 분야별 지원 가능한 세부 내용을 제시한 것으로 수혜기업은 제작전문기업과 협의(견적서 등)를 통해 지원 내용을 결정하고 예산 한도 內(100~500만원)에서 지원하고 필요시 수혜기업에서 추가 금액을 지불하여 제작가능

- ④ (SW 지원) 딥러닝 기반 인공지능의 디바이스 도입을 위해 데이터를 획득, 가공하여 AI 알고리즘 생성을 지원함으로써, 시각언어·청각 인지 기술 등 디바이스에 연계하여 적용 지원

< 지원 내용 및 범위(안) >

구 분	지원내용
인공지능	알고리즘 생성을 위한 데이터 취득, 가공 및 모델 생성 등
빅데이터	데이터 추출·분석, 시각화, 결과 산출 등
통신기술	5G 기술 기반 헬스케어 제작 지원 등

- ⑤ (품질 성능 인증) 혁신디바이스·서비스의 경쟁력 확보를 위해 ICT제품 기술 인증 지원 등의 객관화된 시험 인증을 바우처 형태로 지원

< 지원 내용(안) >

구 분	지원내용
ICT 융합 품질인증	정보통신+방송, 정보통신+기타산업 등 ICT 기술 융합제품 인증
SW 품질인증	모바일, 임베디드, 주문형(SI) SW, 디지털 콘텐츠 등 소프트웨어 전분야
국제공인인증	GCF, PTCRB 등 5G 통신 인증, IoT, oneM2M, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, OCF, USB 등
정보통신시험인증	LAN/MAN, IPv6, 보안장비 등 정보통신기술 시험 성적서 발행
KC인증	전기용품, 생활용품 등 융합 디바이스 대상으로, 해당 제품과 생산설비 등의 안전성에 대해 인증하는 제도
신뢰성 시험	진동, 충격, 환경 등 특정 조건 하의 디바이스의 신뢰수준 평가
NEP·NET 인증	국내에서 최초로 개발한 신제품·신기술 인증

마. 지원 규모 및 예산 ※ 분야별 지원 건수는 수혜기업 모집 상황에 따라 변경 가능

지원분야	수행방식	지원규모(건수)
디자인 제작	바우처지원	6
PCB 설계제작		6
외형 제작		6
SW		2
인증지원		2
계		22

* 지원 예산 범위 : 디자인 제작, PCB 설계제작, 외형 제작 지원은 건당 100만원에서 500만원

2

제작전문기업 선정 및 관리

가. ICT 혁신 디바이스 서비스 제품화 바우처 제작전문기업 구성 및 모집

1) 제작전문기업 모집 방법 및 규모

분야	기업수	모집 방법
디자인제작	2개사	ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 제작전문기업 모집 공고 * 디바이스랩 홈페이지
PCB설계제작	2개사	
외형제작	2개사	
SW지원	2개사	
인증지원	2개사	

2) 제작전문기업(디자인 제작/PCB 설계제작/외형 제작/SW/인증지원) 선정 방법

- (선발절차) 디바이스 분야 제품제작 전문가로 구성된 제품화 심의위원회를 통해 선정
접수 → 제안서 서류 심사 → 합격자 대상 발표평가 → 제작전문기업(바우처공급) 대상 선정

구분	심사방법	비고
접수	<ul style="list-style-type: none"> • 접수 마감일까지 접수 • 제출서류 완비 여부 및 자격조건 확인 • 접수확인 메일발송 	<ul style="list-style-type: none"> * 공고 (6.11.~6.25.)
제작전문기업 선정	<ul style="list-style-type: none"> • 외부 전문가 심사위원단에 의한 서류심사(가이드라인) • 서류심사 합격자 대상의 발표(온라인)평가 추진 • 선정 제작전문기업(공급기업) 사전 면담(설명회) • 제품화 바우처 지원내용에 대한 안내 및 유의사항 전달 	<ul style="list-style-type: none"> * 접수마감일 이후 5일 이내 진행 * 선정 통보 후 일정 조율하여 3월중 진행

3) 평가기준

- 기업역량(70%), 사업 이해도 및 지원 전략(30%) 등 종합평가

평가항목	세부평가내용
기업 역량 (70%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 인적역량 <ul style="list-style-type: none"> - 전문분야 실무경력 5년차 이상 1명을 포함하고 최소 2인 이상의 전문인력을 보유한 기업(총 3인 이상) ▪ 기업역량 <ul style="list-style-type: none"> - 기업 신용등급 B-등급 이상의 기업이거나 또는 직전 3개 사업연도 평균매출액 3억 원 이상인 기업 ▪ 납품실적 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 디바이스 제품 제작 관련 유사 실적(3건/년 평균) 이상 있는 기업 ▪ 전문기업 등록증 <ul style="list-style-type: none"> - 정부부처 및 유관기관의 분야별 전문기업으로 등록된 제작전문기업 (디자인 : 산업디자인진흥법에 따른 산업디자인전문회사 등록증 전문분야 : 제품디자인 분야를 보유한 기업) ▪ 전문장비 보유 <ul style="list-style-type: none"> - 분야별 작업항목에 해당하는 필수 하드웨어 혹은 소프트웨어 장비를 1개(set) 이상 보유·운영 하고 있는 기업
사업 이해도 및 지원전략 (30%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사업능력 <ul style="list-style-type: none"> - 기업지원 취지 등 사업 전반에 대한 이해도 정도 - 바우처 제작전문기업 신청서 내용의 체계성 및 적정성 ▪ 바우처 수행 전략 및 지원서비스 <ul style="list-style-type: none"> - 바우처 기술공급 수행전략의 우수성 - 바우처 지원 서비스 방안 및 내용의 적합성
소계	100%

※ 심의위원회 평가점수를 기준으로 80점 이상인 기업만을 제작전문기업(바우처공급) 적격자로 선정

3

제작전문기업 신청방법

가. 접수기간 : 2021. 6. 11.(금) ~ 6. 25.(금)

나. 신청양식 : 홈페이지 공고문 내 첨부파일 다운로드

다. 신청방법 : 온라인(ICT 디바이스랩 홈페이지 가입 필요)

신청방법	제출처
	디지털 오픈랩 수도권(판교)
이메일	ksw128@gbsa.or.kr
홈페이지	http://www.devicelab.kr/

라. 문 의 처

- 디지털 오픈랩(판교)

· 경기도경제과학진흥원 미래기술진흥팀 (031-710-8707)

마. 제출서류 : 제작전문기업 신청서 및 개인정보제공 동의서

* 제출서류는 반드시 서명 또는 도장이 날인된 서류로 제출

※ 첨부

1. 『ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 사업』 제작전문기업 신청서. 1부.
2. 디바이스 제품화 바우처 개인정보 수집·이용·제공 동의서 각 1부.

『ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 사업』 제작전문기업 신청서

전문 제작 기업 (관)	기업(관)명		사업자등록번호	
	대표자명		설립일자	
	주 소		홈페이지	
	업 태		주요 지원분야	
	대표전화		기업형태	법인 개인
	현 황	담 당 자※	성 명	핸 드 폰
회사전화			E-Mail	
	'18년 매출액	백만원	종업원수	
주요실적 (최근 3년)	연도	지원건수		
			R&D	비R&D
		2018	건	건
		2019	건	건
	2020	건	건	
	주요 납품처		납품일자	주요납품내역
				천원
				천원
				천원
지원가능 프로그램	지원분야		주력 서비스 내용	
	<input type="checkbox"/> 디자인	ex) 제품 컨셉 디자인, 제품 3D 렌더링		
	<input type="checkbox"/> PCB설계제작	ex) 회로설계, PCB 외형 제작, PCB설계		
	<input type="checkbox"/> 외형제작	ex) 모델링 검증, 목업제작, 가공, 기구 설계 등		
	<input type="checkbox"/> SW	ex) 인공지능(AI), 빅데이터 지원 등		
	<input type="checkbox"/> 인증지원	ex) 인증 컨설팅, KC인증, ICT 융합 품질 인증 등		
전문 인력 / 필수장비보유현황	전문인력 수		필수장비 수	
[작성요령]				
1) 주요 실적은 최근 3년간 지원 분야에 대한 주요 납품실적을 최대 3개 이내로 작성한다.				
2) 지원가능 프로그램은 제작전문기업의 지원 분야에 대한 세부 프로그램으로 작성하되, 지원 대상 수혜기업이 이해하기 쉽도록 작성한다.				
3) 실적증빙은 상세납품내용이 기재된 계약서, 거래명세서 또는 세금계산서 등을 인정한다.				
4) 담당자는 본 사업의 실무 책임자로 상시 연락 가능한 전담 인력으로 한다.				
[제출자료]				
1) 전문인력 현황(서식 1) 1부				
2) 제작전문기업 필수장비 보유현황(서식 2) 1부				
3) 주요 실적(주요 납품현황) 증빙사본 각 1부				
4) 제작전문기업 사업자등록증 1부				
5) 최근 3년간 기업재무제표 각 1부				
6) 기업신용등급 증명서 사본 1부				
2021년 월 일				
전문제작기업 대표 :			(인)	

I. 신청기관 일반

1. 사업의 범위(전문제작 서비스 관련)

- 사업의 범위를 기재

2. (신청기관의) 특징 및 장점

- 사업 수행 관련 인적, 물적 자원 및 사업수행 노하우 등을 기재

3. (신청기관의) 전체조직도

II. 신청기관 일반

1. 일반현황 및 연혁

신청기관명		대표자	
사업분야		사업자등록번호 (법인등록번호)	
주소			
전화번호		홈페이지주소	
전체직원수 (임시고용제외)		본사업 참여직원수	
회사설립년도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

2. 기업 신용등급

※ 전문인력 요건은 가이드라인 “별표 1 제품화 제작전문기업 자격기준” 참조

등급기준	신청기업 등급	등급기준	신청기업 등급
AAA		AAA-	
AA		AA-	
A		A-	
BBB		BBB-	
BB		BB-	
B		B-	

작성요령

- 공인기관으로 발급받은 신청기업의 신용등급을 해당란에 √ 체크

3. 관련시설 및 장비 보유현황

※ 전문제작기업의 장비 보유 기준 : 분야별 작업항목에 해당하는 필수 하드웨어 혹은 소프트웨어 장비를 1개(set) 이상 보유하고 있는 기업

※ SW, 인증지원 기업의, 보유장비가 없는 경우 빈칸 으로 제출 할 것.

< 필수 장비(HW·SW) 기준 >

분 야	작업항목	수량	
		HW(Set)	SW(Set)
디자인	<input type="checkbox"/> 디자인 제작		
PCB	<input type="checkbox"/> PCB 설계		
	<input type="checkbox"/> PCB 제작·조립		
외형	<input type="checkbox"/> 외형 설계		
	<input type="checkbox"/> 외형 제작		
SW	<input type="checkbox"/> 인공지능(AI)		
	<input type="checkbox"/> 빅데이터		
	<input type="checkbox"/> 통신기술		
인증	<input type="checkbox"/> 인증지원		

작성요령

- 본사업과 관련 활용 가능한 기자재 및 설비 중 전문 제작 서비스기업(관)에서 보유하고 있는 HW(장비/설비) 및 Software를 기록

III. 참여 서비스 분야별 인력 현황(디자인 제작, PCB 설계제작, 외형 제작, SW, 인증)

1. 참여 인력리스트(전문 인력 3명 이상)

※ 전문인력 요건은 가이드라인 "별표 1 제품화 제작전문기업 자격기준" 참조

연번	성명	직위 (소속기관내)	경력				자격증		비고	기술분야
			회사명	재직기간 (개월)	회사명	재직기간 (개월)	종류	취득 년수		
1	김○○	팀장	애플	48	망고	24		1998	OO수료 (2012)	전자
2	박○○	○○기능사						2000	OO수료 (2014)	-
3	홍○○									

2. 특허출원/등록 건수

연번	출원번호	출원일자	등록일자	특허명칭
1				
2				
3				
4				
5				

3. 기관 실적 리스트 3건 이상

연번	연도	제목	금액	기관명
1				
2				
3				
4				
5				

전문 인력 이력사항

성명		소속		직책		연령	
최종 학력	○○학/석/박사			해당분야 근무경력	년 개월		
전공	(○○전공)			자격증			
본 용역 참여임무				참여 기간	yyyy.mm.dd~ yyyy.mm.dd	참여 율	%

경 력				
사 업 명	참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발 주 처	비고

- 경력사항은 최근 3년간 최근연도순, 고액 순으로 기재
- 자격증 사본 및 경력사항을 증빙할 수 있는 증빙서류 첨부
- 투입인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력 사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가후일지라도 계약업체 선정을 무효화 함

【서식 제1-2호】

[제작전문기업 필수장비 보유현황]

구분	디자인	PCB설계제작	외형제작	SW	인증
보유장비 총 수량					

기자재/시설/장비명	구입년월	규 격	구입가격	수 량	용 도	비 고

ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 사업 개인정보 수집·이용·제공 동의서

디지털 오픈랩은 'ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 사업'의 지원 서비스 제공 및 후속지원연계 등의 지원과 성과조사를 위한 개인정보 수집·이용·제공을 위하여 개인정보보호법 제15조, 제17조 및 제22조에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.

<개인정보 수집·이용에 대한 동의>

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 디지털 오픈랩에서 수집하는 개인정보는 지원자에게 질적으로 뛰어난 제품화 지원 서비스를 제공하며, 지원자가 관심을 가질 만한 지원사업 등의 지원 기회를 소개하고, 지원자의 요구를 이해함으로써 더 나은 서비스를 제공하기 위해 수집·이용합니다.

2. 수집하는 개인정보의 항목

- 필수정보 : 한글성명, 회사명, 연락처(휴대전화, 이메일)
 - 선택정보 : 영문성명, 회사주소, 사업자등록번호, 종업원 수, 직위(직급) 등

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 회원의 정보는 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 파기하는 것을 원칙으로 합니다. 수집하는 개인정보의 이용기간은 이용·제공 동의일로부터 디지털 오픈랩의 지원 거부시 까지며, 보유기간은 거부 후 5년간 보관합니다.

4. 귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다. 동의 거부 시에도 ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처의 제공은 가능하나 **ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 제공, 후속지원연계 제공** 등의 서비스는 제한될 수 있습니다. (단, ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 제공을 위한 최소한의 정보인 필수정보는 미동의시 제공 불가)

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

선택정보	동의함	<input type="checkbox"/>	동의하지 않음	<input type="checkbox"/>
------	-----	--------------------------	---------	--------------------------

<개인정보 제3자 제공 동의(제품화 지원 서비스 제공)>

1. 제공받는 자 : 디지털 오픈랩, 정보통신기획평가원, 경기도경제과학진흥원, 대구테크노파크
2. 제공받는자의 이용 목적 : ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 지원, 성과관리
3. 제공하는 개인정보 항목 : 성명, 회사명, 회사주소, 연락처, 직위(직급) 등
4. 제공받는자의 보유·이용 기간 : 디지털 오픈랩 지원 거부 시까지
5. 귀하는 위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공 되는 것에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 단, 제3자에게 개인정보 제공에 동의하지 않는 경우 **ICT 혁신 디바이스 서비스 바우처 지원**이 제한됩니다.

위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는데 동의하십니까 ?

동의함	<input type="checkbox"/>	동의하지 않음	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	---------	--------------------------

<개인정보 제3자 제공 동의(심의진행, 성과조사, 후속지원연계)>

1. 제공받는 자 : 디지털오픈랩, 정보통신기획평가원, 경기도경제과학진흥원, 대구테크노파크
2. 제공받는자의 이용 목적 : 제품화 지원 심의 운영, 디지털 오픈랩의 운영·지원 성과조사 및 관리, 후속지원연계 제공
3. 제공하는 개인정보 항목 : 성명, 회사명, 사업자등록번호, 회사주소, 연락처, 직위(직급) 등
4. 제공받는자의 보유·이용 기간 : 디지털 오픈랩 지원 거부 시까지
5. 귀하는 위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공 되는 것에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 단, 제3자에게 개인정보 제공에 동의하지 않는 경우 **전시회 참가 지원, 데모데이 참가 지원** 등의 후속지원연계 서비스가 제한됩니다.

위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는데 동의하십니까 ?

동의함	<input type="checkbox"/>	동의하지 않음	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	---------	--------------------------

디지털 오픈랩의 후속지원연계 및 지원사업정보 안내를 위하여 귀하의 개인정보를 이용하는데 동의하십니까?
 동의 거부 시 신규지원사업 정보 안내 및 후속지원연계 등의 지원 서비스 제공이 제한됩니다.

동의함	<input type="checkbox"/>	동의하지 않음	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	---------	--------------------------

- 개인정보 처리에 관한 자세한 사항은 디지털 오픈랩 홈페이지(<http://www.devicelab.kr>)에 공개하고 있는 "개인정보처리방침"을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 법령의 규정 등에 의하여 수집한 개인정보가 수집 및 처리목적에 맞게 이용될 수 있도록 항시 지도·감독하겠습니다.
- ※ 개인정보침해에 관련된 신고는 개인정보침해 신고센터(<http://privacy.kisa.or.kr>)에 하실 수 있습니다.

본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의합니다.

2021년 월 일
신청자 :
(서명/인)